

基本仕様 Basic specifications

SAM-CT1520D

最大ワークサイズ	基板寸法	200mm×150mm×2(t)mm ※実装高さ4mmまで
X 軸	稼働範囲	370mm
	移動速度	500mm/s(MAX)
	スケール分解能	0.001mm
	繰り返し精度	±0.01mm
Y 軸	稼働範囲	350mm
	移動速度	500mm/s(MAX)
	切断時テーブル移動速度	1~200mm/s
	スケール分解能	0.001mm
Z 軸	繰り返し精度	±0.01mm
	稼働範囲	27mm
	移動速度	1~50mm/s
	スケール分解能	0.001mm
θ 軸	最大回転角度	100° (-5°~+95°)
	繰り返し精度	±3°
R 軸	定格出力	90W
ブレード	最大回転数	~1300rpm
	外形×内径×厚み	φ75×φ40×t0.1~0.5
機械本体	電源	3φ AC200V 50/60Hz ※周波数指定
	最大消費電力	3kVA
	エア供給圧	0.5~0.7MPa(無給油)
	エア消費量	300ℓ/min(A.N.R)
	機械サイズ	W800mm×D1210mm×H1300mm ※モニター等を除く
	機械重量	約700kg
	集塵機(出力)	0.75kW
	除電機能	AC高周波式ファンタイプ

Max Board Size		200mm×150mm×2(t)mm ※Max.Height of Components under 4mm
X Axis	Stroke	370mm
	Moving Speed	500mm/s(MAX)
	Resolution	0.001mm
	Repeatability	±0.01mm
Y Axis	Stroke	350mm
	Moving Speed	500mm/s(MAX)
	Table Moving Speed at Cutting	1~200mm/s
	Resolution	0.001mm
Z Axis	Repeatability	±0.01mm
	Stroke	27mm
	Moving Speed	1~50mm/s
	Resolution	0.001mm
θ Axis	Max.Rotary Angle	100° (-5°~+95°)
	Repeatability	±3°
R Axis	Output Power	90W
Blade	Max.Rotary Frequency	~13000rpm
	Outside(D)×Inside(D)×Thickness	φ75×φ40×t0.1~0.5
Machine	Power	3φ AC200V 50/60Hz ※frequency specified
	Max.Power Consumption	3kVA
	Pneumatic	0.5~0.7MPa(cleaning air)
	Air Consumption	300ℓ/min(A.N.R)
	Machine Size	W800mm×D1210mm×H1300mm ※Monitor excluded
	Net Weight	Approx. 700kg
	Dust Collector(Power)	0.75kW
	Static Elimination	AC Type Air Blowing

Dry Picer

SAM-CT1520DFA

最大ワークサイズ	基板寸法	200mm×150mm×2(t)mm ※実装高さ4mmまで
X 軸	稼働範囲	370mm
	移動速度	500mm/s(MAX)
	スケール分解能	0.001mm
	繰り返し精度	±0.01mm
Y 軸	稼働範囲	350mm
	移動速度	500mm/s(MAX)
	切断時テーブル移動速度	1~200mm/s
	スケール分解能	0.001mm
Z 軸	繰り返し精度	±0.01mm
	稼働範囲	27mm
	移動速度	1~50mm/s
	スケール分解能	0.001mm
θ 軸	最大回転角度	100° (-5°~+95°)
	繰り返し精度	±3°
R 軸	定格出力	90W
ブレード	最大回転数	~1300rpm
	外形×内径×厚み	φ75×φ40×t0.1~0.5
ワーク供給P&P	X軸ストローク	650mm
	Z軸ストローク	50mm
ワーク排出P&P	X軸ストローク	700mm
	Z軸ストローク	50mm
機械本体	回転角度	90° (シリンダ)
	電源	3φ AC200V 50/60Hz ※周波数指定
ローダ: アンローダ含む	最大消費電力	4kVA
	エア供給圧	0.5~0.7MPa(無給油)
切断部	エア消費量	600ℓ/min(A.N.R)
	機械サイズ	W2770mm×D1330mm×H1350mm ※モニター等を除く
クリーナー部	機械重量	約1000kg
	集塵機(出力)	0.75kW
切断部	集塵機(出力)	400W(ブラシクリーナー用)
	除電機能	AC高周波式プロタイプ:2個

Max Board Size		200mm×150mm×2(t)mm ※Max.Height of Component under 4mm
X Axis	Stroke	370mm
	Moving Speed	500mm/s(MAX)
	Resolution	0.001mm
	Repeatability	±0.01mm
Y Axis	Stroke	350mm
	Moving Speed	500mm/s(MAX)
	Table Moving Speed at Cutting	1~200mm/s
	Resolution	0.001mm
Z Axis	Repeatability	±0.01mm
	Stroke	27mm
	Moving Speed	1~50mm/s
	Resolution	0.001mm
θ Axis	Max.Rotary Angle	100° (-5°~+95°)
	Repeatability	±3°
R Axis	Output Power	90W
Blade	Max.Rotary Frequency	~13000rpm
	Outside(D)×Inside(D)×Thickness	φ75×φ40×t0.1~0.5
Loader P&P	X Axis Stroke	650mm
	Z Axis Stroke	50mm
Unloader P&P	X Axis Stroke	700mm
	Z Axis Stroke	50mm
Machine	Rotary Angle	90° (cylinder)
	Power	3φ AC200V 50/60Hz ※Frequency specified
Loader/ Unloader included	Max.Power Consumption	4kVA
	Pneumatic	0.5~0.7MPa(cleaning air)
Cutting Portion Cleaner Portion	Air Consumption	600ℓ/min(A.N.R)
	Machine Size	W2770mm×D1330mm×H1350mm ※Monitor excluded
Cutting/Cleaner Portion	Net Weight	Approx. 1000kg
	Dust Collector(Output Power)	0.75kW
Cutting/Cleaner Portion	Dust Collector(Output Power)	400W(for Brush Cleaner)
	Static Elimination	AC Type Air Blowing:2pcs

SAYAKA

株式会社サヤカ
〒143-0002 東京都大田区城南島2丁目3番3号
TEL 03(3790)8911(代表) FAX 03(3790)8917
http://www.sayaka.co.jp
SAYAKA COMPANY LIMITED
3-3, Jyonanjima 2-chome,
Ota-ku, Tokyo143-0002 Japan
TEL 81-3-3790-8911 FAX 81-3-3790-8917
http://www.sayaka.co.jp

信頼のパートナー

・仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
・All specifications are subject to change without prior notice.

乾式ダイサー DryDicer SAM-CT1520D・SAM-CT1520DFA

SAYAKA

乾式ダイサーはサヤカの切断技術、固定技術、粉塵処理技術の全てを凝縮した新型の基板切断装置です。

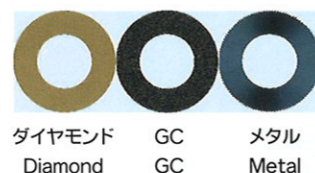
DRY DICER is the latest PCB cutting machine accumulated through and developed by cutting, fixing and dust treatment technologies of SAYAKA.

SAM-CT1520D スタンドアロンタイプ STAND ALONE TYPE

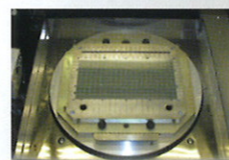


特徴

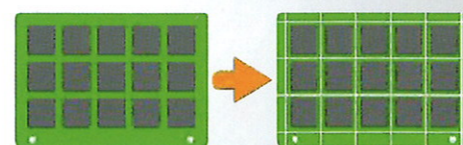
- 1) 高速・高精度な切断
切断速度 20mm/sec ~ 200mm/sec、切断幅 0.1mm ~ 0.5mm を実現し、切断位置は画像処理にて補正を行い切断します。
- 2) ストレス無し
切断にブレードを用いる事により、実装部品やICに与えるストレスは極小です。
- 3) 環境対策、ランニングコストの低減
水を使用しないため給水設備、排水処理を不要とし、また基板の固定に治具を採用する事によりUVテープ等が不要になり、ランニングコストの大幅な低減が計れます。
- 4) 安全な切断、ワークの除電
ブレード破損、摩耗検知を標準装備し、除電を行いながら切断するため安全な切断が可能です。切断対象ワークに最適なブレード (GC: ダイヤモンド: メタルソー etc) を選択し切断可能です。
- 5) 高い操作性
様々な切断モードを揃えており、キーボード操作で容易に行う事が出来ます。エラー発生時にはディスプレイにガイダンス表示が行われ、原因究明、対応が容易に行えます。SAM-CT1520Dは自動扉採用により作業性が向上しました。



ダイヤモンド GC メタル
Diamond GC Metal



真空吸着治具
Vacuum Fixture



加工前
Before

製品
After

Features

- 1) High Speed, High Accurate Cutting
 - Cutting Speed: 20mm/sec ~ 200mm/sec
 - Cutting Width: 0.1mm ~ 0.5mm
 - Cutting made with image correction processing
- 2) No Stress
 - Least stress loaded on component parts and IC with blade used at cutting
- 3) Environmental Countermeasures, Low Running Cost
 - No water supply nor waste water treatments needed with because of no water required
 - No UV tape required with fixture (jig) to fix boards
 - Lowest running cost realized with the above reasons
- 4) Safe Cutting, Static Elimination of Boards
 - Safety cutting realized with detection of blade damage and wear through static elimination
 - Most suitable blade for board selectable (GC: Diamond: Metal saw, etc.)
- 5) High Operability
 - Various cutting modes easily used with key board operation
 - Instruction to errors shown on display and investigation/measures easily made
 - Operability of SAM-CT1520D enhanced with automatic door

SAM-CT1520DFA インラインフルオートタイプ INLINE FULL AUTO TYPE



対象製品 VCO, TCXO, BGA, CSP, MCM, プルーツウース, カメラモジュール, 各種カード基板他

対象基板材質 ガラスエポキシ基板, BTレジン基板, など樹脂系の基板の切断が可能

Boards for Cutting

Materials Applicable for Boards

VCO, TCXO, BGA, CSP, MCM, Bluetooth, CameraModule, VariousCardBoards, etc.

Glass Epoxy, BT Resin and Other Resins.